

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**Process for laser soldering and for temperature monitoring of semi-conductor chips, and chip cards manufactured according to this process**

**Patent number:** DE19850595  
**Publication date:** 2000-07-27  
**Inventor:** SCHEITHAUER HERMANN (DE); ALAVI MANI (DE); SCHMIDT BERTRAM (DE); SCHUMACHER AXEL (DE)  
**Applicant:** HAHN SCHICKARD GES (DE)  
**Classification:**  
- **International:** H01L21/60  
- **European:** B23K1/005R, H01L21/60C4, H01L21/60G, H05K3/34H  
**Application number:** DE19981050595 19981103  
**Priority number(s):** DE19981050595 19981103

**Also published as:** EP0999729 (A2)  
 EP0999729 (A3)

Abstract not available for DE19850595

Abstract of correspondent: EP0999729

A laser beam (32) heats solder (12) applied to a solder point to melting point, and interrupts the beam. The laser beam is applied to the reverse side of a packageless semiconductor chip (10) opposite the side with the solder point. Solder of at least two solder points may be heated simultaneously, or all solder points may be heated at the same time. The laser may be applied for 0.1 to 0.5 seconds, with a focus diameter of 0.1 to 2.0 mm at a power of up to about 10 W.

An Independent claim for a method of ending a soldering process during laser soldering of a semiconductor chip is also included. A chip card is also claimed.

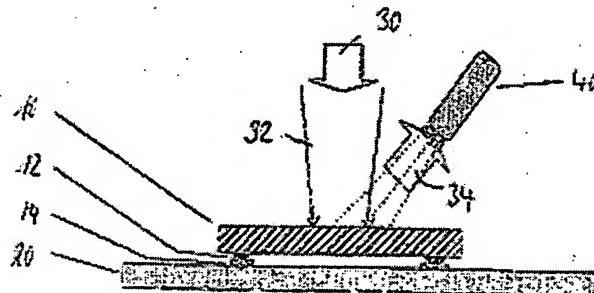


Fig. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)



⑯ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑯ Offenlegungsschrift  
⑯ DE 198 50 595 A 1

⑯ Int. Cl. 7:  
H 01 L 21/60

⑯ Aktenzeichen: 198 50 595.7  
⑯ Anmeldetag: 3. 11. 1998  
⑯ Offenlegungstag: 27. 7. 2000

⑯ Anmelder:  
Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte  
Forschung e.V., 70174 Stuttgart, DE  
⑯ Vertreter:  
Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner,  
78048 Villingen-Schwenningen

⑯ Erfinder:  
Alavi, Mani, Dipl.-Ing. Dr.rer.nat., 78050  
Villingen-Schwenningen, DE; Scheithauer,  
Hermann, Dipl.-Phys., 78073 Bad Dürkheim, DE;  
Schmidt, Bertram, Prof. Dipl.-Phys. Dr., 78052  
Villingen-Schwenningen, DE; Schumacher, Axel,  
78083 Dauchingen, DE

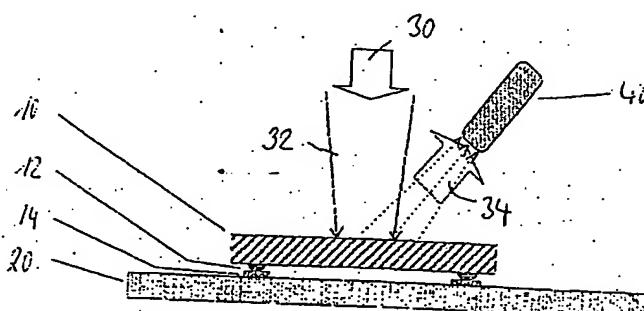
⑯ Entgegenhaltungen:  
DE 37 01 013 C2  
DE 44 46 289 A1  
DE 39 03 860 A1  
DE 36 06 764 A1  
DD 1 40 942

IBM Techn. Disc. Bull., 1992, Vol. 34, Nr. 11,  
S. 362-363;  
EPP, Nov. 1993, S. 47-50;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Verfahren zum Laserlöten und zur Temperaturüberwachung von Halbleiterchips sowie nach diesem Verfahren  
hergestellte Chipkarte  
⑯ Der Laserstrahl (32) wird auf die den Lötstellen abgewandte Rückseite eines gehäusefreien Halbleiterchips (10) gerichtet und nach einer festgelegten Zeit nach dem Erreichen des Schmelzpunktes des auf den Lötstellen aufgebrachten Lotes die Laserbestrahlung unterbrochen. Das Erreichen des Schmelzpunktes wird hierbei durch Detektion der vom Halbleiterchip (10) ausgehenden Wärmestrahlung detektiert. Diese Verfahren sind insbesondere zur Herstellung von Chipkarten geeignet.



## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laserlöten und zur Temperaturüberwachung von Halbleiterchips gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und des Oberbegriffs des Anspruchs 7 sowie eine nach diesem Verfahren hergestellte Chipkarte.

Verfahren zum Laserlöten und zur Temperaturüberwachung von Halbleiterchips sind z. B. in den Dokumenten DE 36 06 764 A1, DE 39 03 860 A1, DE 37 01 013 C2 und DE 38 29 350 A1 beschrieben. Bei diesem bekannten Laserlöten, oder auch Mikrolöten genannt, wird mit Hilfe eines Nd:YAG Laserstrahls nacheinander jede Lötstelle und das darauf aufgebrachte Lot erhitzt, bis dieses schmilzt und eine Kontaktstelle eines Substrates oder einer Chipkarte mit einer Kontaktstelle des Halbleiterchips verlötet ist. Der Lötvorgang wird dadurch überwacht, daß die Wärmeabstrahlung des erhitzen Lotes an der gerade vom Laserstrahl erwärmten Lötstelle mit einem Infrarot-Detektor gemessen und aus dem Meßsignal die beim Erreichen des Lot-Schmelzpunktes entstehende Unstetigkeit zur Unterbrechung des Erhitzungsvorgangs herangezogen wird.

In der bereits genannten DE 37 01 013 C2 wird vorgeschlagen, den Laserstrahl durch ein für Laserlicht durchlässiges Substrat, auf das der Chip gelötet wird, auf die Lötstellen zu richten. Hierdurch können auch SMD-Bauelemente sicher verlötet werden.

Problematisch bei diesem bekannten Laserlötvorfahren ist die Tatsache, daß jede Lötstelle vom Laserstrahl einzeln angefahren werden muß und der komplette Lötvorgang erst dann abgeschlossen ist, wenn sämtliche Lötstellen nacheinander vom Laserstrahl erhitzt worden sind. Dieses Verfahren ist damit verhältnismäßig zeitaufwendig. Es hat sich darüber hinaus herausgestellt, daß der Infrarot-Detektor ein Signal für einen Temperaturverlauf bereitstellt, aus dem nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten und damit unzuverlässig der genaue Schmelzpunkt des Lotes ermittelbar ist. Dies liegt in erster Linie daran, daß der Infrarot-Detektor selbst auf das Lot gerichtet ist. Die Oberfläche des Lotes verändert sich jedoch bei Erwärmung, so daß das Wärmesignal verfälscht ist. Im übrigen ist das bei der Infrarottemperaturnmessung des Lotes erhaltene Signal verhältnismäßig schwach, weil der Emissionskoeffizient von Lötmaterialien, wie z. B. Lötzinn, etwa nur bei 10% liegt.

Ein anderes bekanntes Verfahren zum Löten von Halbleiterchips auf Kontaktstellen eines Substrates oder eines Trägers ist das sogenannte Flip-Chip-Löten. Bei diesem Flip-Chip-Löten wird der Chip auf dem Trägerkörper vorfixiert und das Lot an die Kontaktstellen gebracht. In einem anschließenden Erwärmungsvorgang wird der Chip samt Trägerkörper auf eine ausreichend hohe Temperatur erwärmt, so daß das Lot schmilzen kann. Anschließend wird der Chip und der Trägerkörper wieder abgekühlt, so daß sich das Lot erhärtet und die gewünschten elektrischen Kontakte hergestellt sind.

Problematisch bei diesem Flip-Chip-Löten ist die Tatsache, daß sowohl der Halbleiterchip als auch der Trägerkörper erhitzt und daher verhältnismäßig hohen Temperaturen über längere Zeit ausgesetzt werden. Dies kann zu Schädigungen des Halbleiterchips aber auch zu Schädigungen des Trägerkörpers führen. Eine Erhitzung des Trägerkörpers ist insbesondere dann zu vermeiden, wenn es sich um einen so genannten Niedertemperatur-Trägerkörper handelt. Solche Niedertemperatur-Trägerkörper sind beispielsweise die aus Kunststoff bestehenden Chipkarten. Hier setzt die vorliegende Erfindung an.

Das Ziel der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Laserlöten und zur Temperaturüberwachung von Halbleiter-

chips anzugeben, welche im Vergleich zu den bisherigen Verfahren sowohl zeitlich schneller als auch hinsichtlich der Temperaturbelastung des Halbleiterchips und des Trägerkörpers unkritisch sind. Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, eine nach diesen Verfahren hergestellte Chipkarte anzugeben.

Dieses Ziel wird für das Verfahren zum Laserlöten von Halbleiterchips durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Das Verfahren zur Temperaturüberwachung, das bevorzugt 10 gleichzeitig zu dem erfindungsgemäßen Verfahren des Laserlötens angewandt wird, jedoch auch bei herkömmlichen Laserlötvorgängen einsetzbar ist, ist Gegenstand des Anspruchs 7.

Eine Chipkarte nach der Erfindung ist im Patentanspruch 15 angegeben.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der auf diese Ansprüche zurückbezogenen Unteransprüche.

Das Verfahren zum Laserlöten von Halbleiterchips nach der Erfindung besteht im wesentlichen darin, daß der Laserstrahl auf die den Lötstellen abgewandte Rückseite des gehäusefreien Halbleiterchips gerichtet wird. Der Laserstrahl wird also im Gegensatz zu dem bekannten Verfahren nicht auf die Lötstelle selbst oder auf das dort befindliche Lot gerichtet, sondern auf das gehäusefreie Halbleiterchip. Der Halbleiterchip erwärmt sich und fungiert als Wärmeleiter für das Lot, so daß das auf der Unterseite des Halbleiterchips an den jeweiligen Kontaktstellen des Halbleiterchips angebrachte Lot schmilzen kann. Es werden also sämtliche Lötstellen gleichzeitig durch die Erwärmung des Halbleiterchips geschmolzen, so daß die Lötkontakte sehr schnell hergestellt werden können.

In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Laserbestrahlung des Halbleiterchips für etwa 0,1 bis 0,5 sec durchgeführt wird. Versuche haben gezeigt, daß diese sehr kurze Zeitspanne ausreichend ist, um den Halbleiterchip soweit zu erhitzen, daß dessen darunter befindliches Lot sicher aufschmilzt. Dieses sehr kurzeitige Erhitzen des Halbleiterchips stellt sicher, daß die Funktionen des Halbleiterchips erhalten bleiben. Versuche bei der Anmelderin haben ergeben, daß kein Halbleiterchip nach dem erfolgten Lötvorgang in seiner Funktionsweise beeinträchtigt war.

Das Lötverfahren nach der Erfindung wird vorzugsweise dazu genutzt, sämtliche Lötstellen auf dem Halbleiterchip simultan zu löten. Hierbei wird die hohe Wärmeleitfähigkeit 45 des Halbleitermaterials des Halbleiterchips ausgenutzt. Als Halbleitermaterial kommt bevorzugt Silizium zur Anwendung. Es können jedoch auch andere Halbleitermaterialien, wie z. B. Galliumarsenid oder dergleichen vorgesehen werden. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Halbleitermaterials 50 des Halbleiterchips führt bei typischen Chipabmessungen von wenigen Quadratmillimetern zu einer praktisch gleichförmigen Erwärmung des Halbleiterchips. Durch das gleichzeitige Löten sämtlicher Lötstellen tritt vorteilhafterweise 55 kein sogenannter "Grabstein-Effekt" auf. Hierunter versteht man das Aufrichten des Chips bzw. des zu lögenden Bauteiles, nachdem eine Lötstelle am Rand realisiert ist.

Ein sehr wesentlicher und sehr wichtiger Vorteil bei dem Laserlötvorfahren besteht in der sehr geringen Temperaturbelastung des Trägerkörpers bzw. des Substrates, auf das der Halbleiterchip gelötet wird. Ist der Trägerkörper ein Niedertemperaturträgerkörper, wie dies beispielsweise die Chipkartenträgerkörper sind, so ertragen diese lediglich Temperaturen von 60 bis 70°C, wenn die Erwärmung länger als 1 sec dauert. Es hat sich herausgestellt, daß das erfindungsgemäße Lötverfahren ideal auch zum Auflöten von Halbleiterchips auf solche Niedertemperatursubstrate geeignet ist. Dies ist deshalb möglich, weil auf dem Substrat metallische Leiterbahnen vorhanden sind, auf welche der Halbleiterchip

gelötet wird. Die metallischen Leiterbahnen treten als Wärmesenke auf und verhindern eine Schädigung des Substrates. Die zum Löten erforderliche Temperatur von etwa 250 bis 300°C am Lötspalt wird erfahrungsgemäß jedoch nur für etwa 0,1 sec bis maximal 0,5 sec benötigt. Dieses sehr kurzeitige Erwärmen der Lötstellen sorgt in Verbindung mit den metallischen Leiterbahnen auf dem Substrat dafür, daß dieses nicht beeinträchtigt wird.

Die erforderliche Laserleistung liegt im Bereich mehrerer Watt. Der Fokus des Laserstrahls auf der Rückseite des Halbleiterchips hat erfahrungsgemäß einen Durchmesser von 0,1 bis 2 mm. Dies reicht aus, um den Halbleiterchip ganzflächig oder nahezu ganzflächig zu erwärmen, so daß dieser als guter Wärmeleiter die Temperaturerhöhung an die Lötstellen weitergeben kann.

Der Zeitpunkt, wann die Wärmezufuhr durch die Laserbestrahlung unterbrochen wird, kann prinzipiell auf herkömmliche und damit bekannte Art und Weise erfolgen. Dies bedeutet, daß mit einem Infrarot-Detektor die Temperatur der Lötstellen oder zumindest einer der Lötstellen erfaßt wird.

Gemäß vorliegender Erfindung wird der Zeitpunkt des Schmelzens des Lotes auf zuverlässigere Art erfaßt. Hierfür wird ebenfalls ein infrarotempfindlicher Sensor eingesetzt, um das Erreichen des Schmelzpunktes des Lotes zu überwachen. Bei Erreichen des Schmelzpunktes wird ein Signal zur Laserstrahlunterbrechung an eine Steuereinrichtung geleitet, die das Laserlicht nach einer festgelegten Zeit, in der der Benetzungsvorgang stattfindet, abschaltet. Erfahrungsgemäß wird der Infrarot empfindliche Sensor auf die Rückseite des gehäusefreien Halbleiterchips gerichtet. Durch diese berührungslose Infrarottemperaturmessung der Temperatur der Rückseite des Halbleiterchips ergibt sich ein wesentlich stärkeres Temperatursignal als bei der Erfassung einzelner Lötstellen. Dies unter anderem auch deswegen, weil der Emissionskoeffizient des Siliziums je nach Oberflächenrauhigkeit etwa 45% bis 90% beträgt, der des Lotes aber nur etwa 10%. Zudem, und dies ist besonders wichtig, bleibt die als Wärmespiegel wirkende Rückseite des Halbleiterchips geometrisch konstant, so daß das Wärmesignal nicht durch veränderliche, aufschmelzende Oberflächen beeinträchtigt wird, wie dies bei der direkten Temperaturmessung der Lötstelle der Fall wäre.

Da während des Laserlötorganges der Temperatur-Zeit-Verlauf sehr sicher erfaßt wird, kann die Laserbestrahlung zuverlässig gestoppt werden, sobald der Lötorgang beendet ist. Das Schmelzen ist im Temperatur-Zeit-Verlauf an einer auftretenden Unstetigkeit, d. h. an einer abrupten Änderung des Anstieges des Temperatur-Zeit-Verlaufes zu erkennen, weil einerseits der Phasenübergang beim Schmelzen des Lotes Wärme verbraucht und andererseits durch die entstehende Lötverbindung die Wärmeleitung zu den als Wärmesenke wirkenden Metallleiterbahnen auf dem Trägerkörper bzw. Substrat deutlich vergrößert wird.

Diese abrupte Änderung des Anstieges des Temperatur-Zeit-Verlaufes kann sehr sicher detektiert werden, wenn dieser Kurvenverlauf vorzugsweise durch Frequenzfilterung vom Rauschen befreit und anschließend nach der Zeit differenziert wird, also die erste Ableitung des Temperatur-Zeit-Verlaufes gebildet wird. In diesem differenzierten Signalverlauf ist die abrupte Änderung des Anstieges des Temperatur-Zeit-Verlaufes nach wenigen Millisekunden durch eine Unstetigkeitsstelle oder einen Wendepunkt bestimmt.

Bei dem erfahrungsgemäßen Verfahren wird vorzugsweise ein Substrat mit metallischen Kontaktflächen bereitgestellt, und der Halbleiterchip mit seinen Lötstellen über diesen Kontaktflächen platziert. Die Lötstellen werden dann mit diesen Kontaktflächen verlötet. Das Substrat ist vor-

zugsweise ein Niedertemperatursubstrat und insbesondere der Trägerkörper für eine Chipkarte. Das Substrat kann aus Kunststoff, einem Polymer oder einer Polymerverbindung bestehen.

In einer bevorzugten Anwendung der Erfindung, wird der Halbleiterchip auf dem Substrat vor dem Laserlötorgang vorfixiert. Dies ist jedoch nicht zwingend.

Das erfahrungsgemäße Verfahren und eine Chipkarte, die nach diesem Verfahren hergestellt wird, werden nachfolgend im Zusammenhang mit drei Figuren beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Die schematische Schnittdarstellung eines auf einem Niedertemperatursubstrat aufgesetzten Halbleiterchips, das nach dem erfahrungsgemäßen Verfahren auf das Niedertemperatursubstrat gelötet wird,

Fig. 2 einen ersten Kurvenverlauf des Temperatur-Zeit-Verhaltens der Rückseite des Halbleiterchips, und

Fig. 3 weitere Beispiele von Temperatur-Zeit-Verläufen und deren zugehörende differenzierten Kurvenverläufe.

In Fig. 1 ist schematisch die Schnittdarstellung eines Halbleiterchips 10 dargestellt, der auf einem Niedertemperatursubstrat 20 sitzt. Das Niedertemperatursubstrat 20 kann beispielsweise eine aus Kunststoff bestehende, scheckkartengröße aufweisende Trägerkarte sein, die später als Chipkarte fungiert, wenn das Halbleiterchip 10 fertig montiert ist. Das Niedertemperatursubstrat 20 weist auf seiner Oberseite Kontaktflächen 14 auf, die aus Metall, wie z. B. Gold oder Kupferbahnen etc., bestehen. Der Halbleiterchip 10, vorzugsweise ein Siliziumchip, verfügt an seiner Unterseite und damit der dem Niedertemperatursubstrat 20 zugewandten Fläche über Kontaktstellen, auf denen bereits Lotbumps aufgebracht sind. Das Lot bzw. die Lotbumps sind mit dem Bezugszeichen 12 versehen. Obwohl in Fig. 1 nur zwei Kontaktflächen 14 und zwei Lotbumps 12 dargestellt sind, kann der Halbleiterchip 10 und das Niedertemperatursubstrat 20 über eine Vielzahl solcher zu kontaktierenden Stellen aufweisen.

Um das Lot 12 auf die Kontaktflächen 14 des Niedertemperatursubstrats 20 zu löten, wird mit Hilfe eines Laserstrahls 32 einer Laserlichtquelle 30 die Rückseite, d. h. die dem Niedertemperatursubstrat 20 abgewandte Oberfläche des Halbleiterchips 10 erwärmt. Hierfür wird der Laserstrahl 32 so auf die Rückseite des Halbleiterchips 10 gestrahlt, daß dort ein Fokus von etwa 0,1 mm bis 2 mm Durchmesser auftrifft. Dies ist ausreichend für eine sichere Erwärmung des gesamten Halbleiterchips 10. Die erforderliche Laserleistung liegt im Bereich mehrerer Watt, z. B. 10 Watt. Zur Anwendung kommen u. a. Nd:YAG-Laser und Diodenlaser im cw-Betrieb. Typische Wellenlängen liegen zwischen 800 und 1100 nm.

Nachdem die Laserlichtquelle 30 eingeschaltet ist und der Laserstrahl 32 auf die Rückseite des Halbleiterchips 10 strahlt, erwärmt sich dieser und gibt diese Erwärmung an die Lotbumps 12 weiter. Bei ausreichender Erhitzung schmilzt das Lot 12. Dieser Zeitpunkt wird mit einem infrarotempfindlichen Sensor 40 detektiert.

Der Temperatursensor 40 ist ebenfalls auf die Rückseite des Halbleiterchips 10 gerichtet und detektiert dessen Wärmeabstrahlung. Die Oberfläche des Halbleiterchips 10 wirkt damit als Wärmespiegel. Die vom Temperatursensor 40 erfaßte Wärmestrahlung ist in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 34 versehen.

In Fig. 2 ist ein typischer Kurvenverlauf des Temperatur-Zeit-Verhaltens, wie er von dem Temperatursensor 40, der ein Infrarotsensor sein kann, gemessen wird, grafisch dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit in Sekunden und auf der vertikalen Achse die vom Temperatursensor 40 gemessene Temperatur in Grad Celsius aufgetragen. Es ist

deutlich zu erkennen, daß zu Beginn der Laserbestrahlung der Rückseite des Halbleiterchips 10 dessen Temperatur sehr stark ansteigt und nach etwa 0,2 sec etwa eine Temperatur von ca. 200°C erreicht. Anschließend nimmt die Temperatur nur sehr schwach zu, um sich bis zu dem Zeitpunkt von etwa 0,3 sec nicht mehr sehr viel weiter zu erhöhen. Die Temperatur liegt nach 0,3 sec bei etwa 210°C. Anschließend ändert sich jedoch die Steigung der Temperatur ganz deutlich. Die Temperatur steigt linear bis 0,55 sec auf etwa 250° an. Der Schmelzzeitpunkt des Lotes 12 ist durch die abrupte Änderung des Anstieges der Temperatur gekennzeichnet. Dies ist etwa bei 0,3 sec der Fall.

Sobald der Temperatursensor 40 diese abrupte Änderung im Anstieg der Temperatur erfaßt, kann ein Signal an eine Steuereinrichtung abgegeben werden, durch welche der Laserstrahl 32 nach einer festgelegten Zeit unterbrochen wird.

In Fig. 3 sind drei weitere Beispiele von konkret gemessenen Temperatur-Zeit-Kurven nebeneinander dargestellt. Sämtliche drei Kurvenverläufe zeichnen sich dadurch aus, daß die Temperatur mit einer verhältnismäßig hohen Steigung bis etwa 0,15 sec linear ansteigt, um dann in einen Kurvenverlauf überzugehen, der zwar linear ansteigt, jedoch weniger stark. Diese abrupte Änderung in der Steigung des Temperaturverhaltens ist wiederum ein konkreter Anhaltspunkt dafür, daß der Schmelzpunkt des Lotes erreicht ist.

In Fig. 3 unten ist zu den Temperaturverläufen jeweils die zugehörende erste Ableitung schematisch gezeigt. Die Änderung in der Steigung des Temperaturverhaltens macht sich im Signal der ersten Ableitung durch einen Sprung des differenzierten Signales bzw. durch eine Unstetigkeitsstelle oder einen Wendepunkt bemerkbar. Es bietet sich deshalb an, daß nach der Zeit differenzierte Signal auszuwerten, um den Laserstrahl abzuschalten.

Eine Chipkarte, die nach diesem Verfahren hergestellt ist, zeichnet sich durch einen in oder auf einem Kartenträger oder ein Substrat angeordneten Halbleiterchip aus, dessen Lötstellen mit Kontaktflächen des Kartenträgers oder Substrates gleichzeitig durch Laserlöting verlötet worden sind. Die Erfindung ist jedoch nicht auf Chipkarten beschränkt, sondern kann auch auf jegliche andere Substrate oder Träger, auf die ein Halbleiterchip aufgelötet werden soll, angewandt werden. Die Erfindung ist deshalb auch auf SMD-Bauteile, die auf Trägerplatten gelötet werden sollen, ideal anwendbar, sofern der Halbleiterchip gehäusefrei ist.

#### Bezugszeichenliste

- 10 Halbleiterchip
- 12 Lot
- 14 Kontaktfläche
- 20 Substrat
- 30 Laserlichtquelle
- 32 Laserstrahl
- 34 Wärmestrahlung
- 40 Temperatursensor
- s Sekunde
- T Temperatur
- X Schmelzzeitpunkt
- t Zeit
- t/Δ 1. Ableitung

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Laserlöten von Halbleiterchips (10), bei welchem mit einem Laserstrahl (32) das auf Lötstellen aufgebrachte Lot (12) bis zum Erreichen eines Schmelzpunktes erhitzt und anschließend die Laserbestrahlung unterbrochen wird, dadurch gekennzeich-

net, daß der Laserstrahl (32) auf die den Lötstellen abgewandte Rückseite des gehäusefreien Halbleiterchips (10) gerichtet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Lot (12) von mindestens zwei Lötstellen gleichzeitig erhitzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Lot sämtlicher Lötstellen gleichzeitig erhitzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbestrahlung des Halbleiterchips (10) etwa 0,1 bis 0,5 Sekunden durchgeführt wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbestrahlung des Halbleiterchips (10) mit einem Fokus des Laserlichts auf der Rückseite des Halbleiterchips (10) erfolgt, der etwa einen Durchmesser von 0,1 bis etwa 2,0 mm hat.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Leistung der den Laserstrahl (32) bereitstellenden Laserlichtquelle (30) bis zu etwa 10 Watt beträgt.
7. Verfahren zum Beenden des Lötvorgangs beim Laserlöten von Halbleiterchips (10) gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1, wobei mit Hilfe eines berührungslosen, temperaturempfindlichen Sensors (40) das Erreichen des Schmelzpunktes des Lotes (12) überwacht und bei Erreichen des Schmelzpunktes ein Signal zur Laserstrahlunterbrechung an eine Steuereinrichtung geleitet wird; dadurch gekennzeichnet, daß der temperaturempfindliche Sensor (40) auf die Rückseite des gehäusefreien Halbleiterchips (10) gerichtet ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß während des Laserlöts der Temperatur-Zeit-Verlauf der Wärmestrahlung des Halbleiterchips (10) erfaßt und bei einer abrupten Änderung des Anstieges des Kurvenverlaufs das Signal zur Laserstrahlunterbrechung bereitgestellt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die abrupte Änderung des Temperatur-Zeit-Verlaufes durch eine Unstetigkeitsstelle oder einen Wendepunkt in dem nach der 1. Ableitung zeitlich differenzierten Signal des Temperatur-Zeit-Verlaufes bestimmt ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Substrat (20) mit metallischen Kontaktflächen (14) bereitgestellt wird, daß der Halbleiterchip (10) mit seinen Lötstellen über diesen Kontaktflächen (14) platziert wird, und daß die Lötstellen mit diesen Kontaktflächen (14) verlötet werden.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (20) aus Kunststoff, einem Polymer oder einer Polymerverbindung besteht.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (20) ein Chipkartenträger ist.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Halbleiterchip (10) auf dem Substrat (20) vor dem Laserlötvorgang vorfixiert wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterchip (10) ein Silizium- oder GaAS-Chip ist.
15. Chipkarte mit einem in oder auf einem Kartenträger oder Substrat (20) angeordneten Halbleiterchip (10), dessen Lötstellen mit Kontaktflächen (14) des Kartenträgers oder Substrats (20) gleichzeitig verlötet

worden sind.

16. Chipkarte nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterchip (10) ein Silizium- oder GaAS-Chip ist.

5

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

**- Leerseite -**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

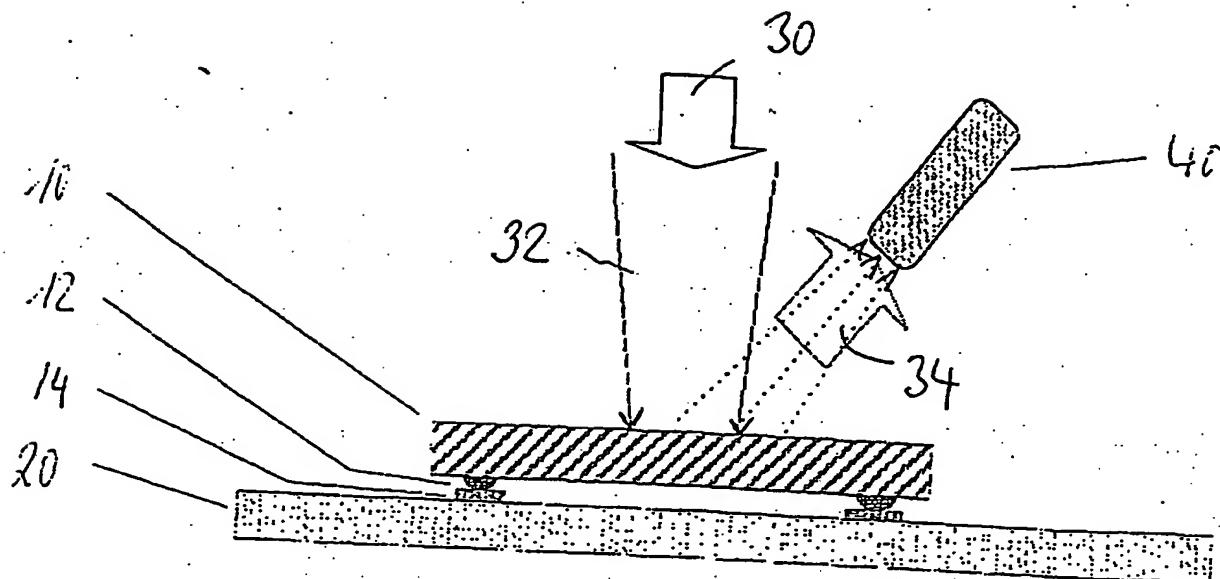


Fig. 1

